



(JAC Career) DSSBU SPEシステム部／エッチング装置プロセス開発エンジニア

大手半導体製造装置メーカーでの募集です。商品企画・商品開発（技術系）のご経験...

Job Information

Recruiter

JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company

大手半導体製造装置メーカー

Job ID

1500482

Industry

Machinery

Job Type

Permanent Full-time

Location

Tokyo - Other Areas

Salary

5 million yen ~ 11 million yen

Work Hours

09:00 ~ 17:30

Holidays

【有給休暇】初年度 最大12日 1か月目から（入社時期により付与日数は変動します）【休日】完全週休二日制 土 日 祝日 GW...

Refreshed

January 2nd, 2025 15:00

General Requirements

Career Level

Mid Career

Minimum English Level

Business Level

Minimum Japanese Level

Native

Minimum Education Level

High-School

Visa Status

Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2259154】

【業務内容】

- 半導体向けエッチング装置のプロセスエンジニアまたはマネジメント業務を行います。
- ・半導体前工程、特にエッチングプロセスを理解した上で、所属営業部の戦略を理解し、顧客のプロセス要求や目的を把握して自社のエッチング装置のプロセス開発および条件出しを行います。
 - ・顧客向けのプロセス報告書を作成し、直接顧客へ報告を上司や営業と一緒にいきます。
 - ・顧客サイトでの条件だしサポートが必要な場合は、現地に赴いて顧客CRで作業する事もあります。
 - ・必要に応じて上長・先輩社員の指示・指導・アドバイスを受けながら、非定型業務を担当します。

Required Skills

【必須】

半導体およびフラットパネルのエッチング装置に関するプロセス技術の実務経験が2年以上ある方。

【尚可】

半導体製造装置の海外営業またはマーケティング経験のある方。

Company Description

ご紹介時にご案内いたします